

## 科技部 函

地址：臺北市和平東路二段106號  
聯絡人：杜青駿 副研究員  
電話：02-2737-7527  
傳真：02-2737-7673  
電子信箱：cctu@most.gov.tw

受文者：國立政治大學

發文日期：中華民國110年9月10日  
發文字號：科部工字第1100056138B號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：(110E0P000162\_110D2023182-01.pdf)

主旨：本部「發展智慧製造及半導體先進製程資安實測場域專案計畫」自即日起受理申請，請於110年10月15日(星期五)前函送達本部，逾期不予受理，請查照轉知。

說明：

一、為落實5+2產業創新計畫之「智慧機械」、「六大核心戰略產業」之「發展結合5G、數位轉型和國家安全的資安產業」等行政院重要科技政策，爰規劃推動旨揭「發展智慧製造及半導體先進製程資安實測場域專案計畫」，由學界進行智慧製造及半導體製程之資安技術研發，且必須在智慧製造場域及半導體製程場域進行實測驗證，並將研發成果推廣至產業應用，同時培育工控資安科研人才。

二、申請機構及計畫主持人務必先行詳閱本計畫徵求公告(如附件)，申請注意事項說明如下：

(一)本專案計畫以前瞻研發、產學合作、落實產業應用為目標。

1、計畫團隊必須具備實測場域，並於計畫書中載明場域

之設施及規格。藉由IEC 62443等相關規範進行弱點掃描、資安檢測，以瞭解目前場域中資安防護能量不足之處。

- 2、必須以產業技術需求(demand pull)為導向，針對智慧製造及半導體製程之資安技術缺口進行研發。
- 3、必須具體掌握預計研發目標技術之國內現況與國際比較、與國際標竿之比較(需有明確規格與數據)；此外，藉由本計畫之投入，目標技術預期可提升程度。
- 4、須達成本專案計畫每年度訂定之目標，並訂定可供查核的技術面KPI。
- 5、須邀請國內業界參與共同執行計畫，提案時請一併檢附合作企業參與計畫意願書，並請提高合作企業的實質參與，相關作法包含：
  - (1)合作企業提供研究設備、實測場域、研發人力...等。
  - (2)鼓勵合作企業投入研究經費。若執行機構與企業完成簽訂合約書，且企業已撥付挹注金後，計畫主持人可依本部「研究計畫產學增值鼓勵方案(達陣方案)」，申請追加經費。
  - (3)鼓勵合作企業培育人才，例如學生至合作企業實習，或依本部「鼓勵企業參與培育博士研究生試辦方案」，由業界及本部共同挹注經費以培育優秀博士生。

## (二)跨領域、跨單位共同合作。

- 1、本專案計畫為單一整合型計畫，主持人需具備智慧製



造或半導體製程技術背景專長，共同主持人需具備資安技術專長。

2、由國家實驗研究院國家高速網路與計算中心進行弱點掃描、滲透測試、資安檢測、攻防演練等，協助各計畫團隊精進資安防護技術；由台灣儀器科技研究中心進行工控資安人才培育。

(三)本專案計畫訂有嚴謹的考評與退場機制，以淘汰執行成效不佳的計畫團隊；此外，本部亦得整併計畫團隊、調整計畫成員、或調整計畫執行內容。

三、線上申請時，請選擇「專題類-隨到隨審計畫」，計畫類別請選擇「一般策略專案計畫」，計畫歸屬請選擇「工程司」。研究型別請選擇「整合型計畫」，學門代碼請選擇「E9865物聯網應用場域資安強化推動計畫」。

四、本專案計畫恕不受理申覆。

五、有關線上申請系統操作問題，請洽本部資訊系統服務專線，電話：(02)27377590、27377591、27377592，電子郵件信箱：misservice@most.gov.tw。

正本：專題研究計畫受補助單位（共302單位）

副本：本部綜合規劃司、資訊處、工程司(均含附件)



部長吳政忠